



$$\frac{P_e}{P} \times 100 \% \geq 40 \%$$

Pe - efektywna powierzchnia przyklejenia
płyty termoizolacyjnej do podłoża

P - powierzchnia płyty termoizolacyjnej
przylegająca do ściany

Do klejenia izolacji termicznej używa się fabrycznie przygotowanych dyspersyjnych mas klejowych w przypadku podłoży nienasiąkliwych i drewnopochodnych, lub cementowych zapraw klejowych do zmieszania z wodą na budowie w przypadku typowych podłoży budowlanych.

Zaprawę klejową należy przygotowywać według zaleceń producenta (instrukcje i karty techniczne) również w przypadku fabrycznie przygotowanych klejów dyspersyjnych, które wymagają zmieszania z cementem celem przygotowania właściwej zaprawy klejowej.

Klej należy nanosić na płyty izolacyjne według tzw. metody obwodowo-punktowej. Na płytę nanosić taką ilość zaprawy, aby uwzględniając nierówności podłoża i możliwą do położenia warstwę kleju (ok. 1 do 2 cm) zapewnić minimum 40% efektywnej powierzchni przyklejenia płyty do podłoża

(przy większych nierównościach należy stosować zróżnicowanie grubości izolacji). Po obwodzie płyty wzdłuż jej krawędzi należy nanieść około 5 cm szerokości pasmo zaprawy i dodatkowo w środku płyty nałożyć minimum 3 placki zaprawy wielkości dłoni.

Na równych podłożach można nakładać zaprawę na płytę termoizolacyjną całopowierzchniowo przy użyciu pacy zębatej (ok. 10 mm).

Jednostka projektowa:	 INSTAL-SANT Krystian Dydak ul. Warta 29, 42-300 Myszków tel.: 513 610 129 NIP: 5771956348 REGON: 243599307				
Inwestor:	Gmina Włodowice z siedzibą przy ul. Krakowska 26, 42-421 Włodowice				
Temat:	Termomodernizacja budynku przy ul. Wiejskiej w Rzędkowicach - UE				
Faza:	PROJEKT WYKONAWCZY				
	Imię i Nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień:	Data:	Podpis:
Projektował:	mgr inż. arch. Marek Kozieł	architektoniczna	16/DSOKK/2012	10.04.2017	
Sprawdził:	mgr inż. arch. Łukasz Reszka	architektoniczna	27/2010/DOIA	10.04.2017	
Nazwa rysunku:	1. Detal 1 - Sposób klejenia styropianowych płyt izolacji termicznej			Skala:	1:10
				Nr rys.:	A11